DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Leiterplatten-Grundleiste

1845166

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 0,5 mm^2, Farbe: schwarz, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Au, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 32, Anzahl der Reihen: 2, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 32, Artikelfamilie: DMC 0,5/..-G1-SMD, Rastermaß: 2,54 mm, Montage: SMD-Löten, Pin-Layout: Lineare Pad-Geometrie, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON DFMC 0,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: Gurt in 72 mm Breite

Ihre Vorteile

- Vergoldete Kontaktstellen sichern die langzeitstabile Übertragungsqualität
- Ausgelegt für die Integration in den SMT-Prozess
- Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1845166
Verpackungseinheit	300 Stück
Mindestbestellmenge	300 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	E1 - Leiterplattenanschl.
Produktschlüssel	AAAUDA
GTIN	4046356964708
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,976 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,22 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	PL

DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Leiterplatten-Grundleiste

1845166

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leiterplatten-Grundleiste
Produktfamilie	DMC 0,5/..-G1-SMD
Produktlinie	COMBICON Connectors XS
Polzahl	16
Rastermaß	2,54 mm
Anzahl der Anschlüsse	32
Anzahl der Reihen	2
Anzahl der Potenziale	32
Befestigungstyp	ohne
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie
Anzahl Lötpins pro Potenzial	1

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften

Nennstrom I_N	6 A
Nennspannung U_N	160 V
Durchgangswiderstand	2,8 mΩ
Bemessungsspannung (III/3)	32 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Bemessungsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Bemessungsspannung (II/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV

Montage

Montageart	SMD-Löten
Pinlayout	Lineare Pad-Geometrie

Verarbeitungshinweise

Prozess	Reflowlötung
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C
Lötzyklen im Reflow	3

Materialangaben

Materialangaben - Kontakt

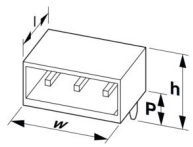
Hinweis	WEEE/RoHS konform, whisker-frei nach IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material Kontakt	Cu-Legierung
Oberflächenbeschaffenheit	komplett vergoldet

Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht)	Gold (0,25 Au)
Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht)	Nickel (2 - 4 µm Ni)
Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht)	Gold (0,25 Au)
Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht)	Nickel (2 - 4 µm Ni)

Materialangaben - Gehäuse

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Isolierstoff	LCP
Isolierstoffgruppe	IIIa
CTI nach IEC 60112	175
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Maßzeichnung	
Rastermaß	2,54 mm
Breite [w]	45,22 mm
Höhe [h]	7,39 mm
Länge [l]	12,26 mm
Stiftabmessungen	0,64 x 0,64 mm

Leiterplatten-Design

Pad-Geometrie	1,2 x 2,1 mm
	1,2 x 3,8 mm
Stiftabstand	2,54 mm

Mechanische Prüfungen

Sichtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-1-1:2003-01
Ergebnis	Prüfung bestanden

Maßprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-1-2:2003-01
Ergebnis	Prüfung bestanden

Beständigkeit von Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-70:1996-07
Ergebnis	Prüfung bestanden

Polarisation und Kodierung

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-13-5:2006-11
Ergebnis	Prüfung bestanden

Kontakthalterung im Einsatz

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-15-1:2009-03
Kontakthalterung im Einsatz Anforderung >20 N	Prüfung bestanden

Steck- und Ziehkräfte

Ergebnis	Prüfung bestanden
Anzahl der Zyklen	100
Steckkraft je Pol ca.	2 N
Ziehkraft je Pol ca.	1 N

Elektrische Prüfungen

Thermische Prüfung | Prüfgruppe C

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-5-1:2003-01
Geprüfte Polzahl	16

Isolationswiderstand

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-3-1:2003-01
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 5 MΩ

Luft- und Kriechstrecken |

Prüfspezifikation	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Isolierstoffgruppe	IIIa
Kriechstromfestigkeit (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
Bemessungsisolationsspannung (III/3)	32 V
Bemessungsstoßspannung (III/3)	2,5 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/3)	1,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/3)	1,3 mm
Bemessungsisolationsspannung (III/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (III/2)	2,5 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (III/2)	1,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (III/2)	1,6 mm
Bemessungsisolationsspannung (II/2)	160 V
Bemessungsstoßspannung (II/2)	2,5 kV
Mindestwert der Luftstrecke - inhomogenes Feld (II/2)	1,5 mm
Mindestwert der Kriechstrecke (II/2)	1,6 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Vibrationsprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frequenz	10 - 500 - 10 Hz
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min
Amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Beschleunigung	5g (60,1 Hz ... 500 Hz)

Prüfdauer je Achse	2 h
Prüfrichtungen	X-, Y- und Z-Achse

Lebensdauerprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
Stehstoßspannung auf Meereshöhe	2,95 kV
Durchgangswiderstand R_1	2,8 mΩ
Durchgangswiderstand R_2	2,9 mΩ
Steckzyklen	100
Isolationswiderstand benachbarte Pole	> 5 MΩ

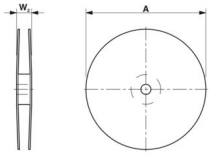
Klimatische Prüfung

Prüfspezifikation	DIN 50018:2013-05
Korrosionsbeanspruchung	1,0 dm^3 SO_2 auf 300 dm^3/40 °C/3 Zyklen
Wärmebeanspruchung	105 °C/168 h
Stehwechselspannung	1,39 kV

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Derating-Kurve)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C

Verpackungsangaben

Maßzeichnung	
Verpackungsart	Gurt in 72 mm Breite
Gurtbreite [W]	72 mm
Spulenaussenmaß [W2]	≤ 78,4 mm
Spulendurchmesser [A]	≤ 330 mm
Art der Umverpackung	Transparent-Bag
ESD - Level	(D) elektrostatisch ableitfähig
Prüfspezifikation	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07

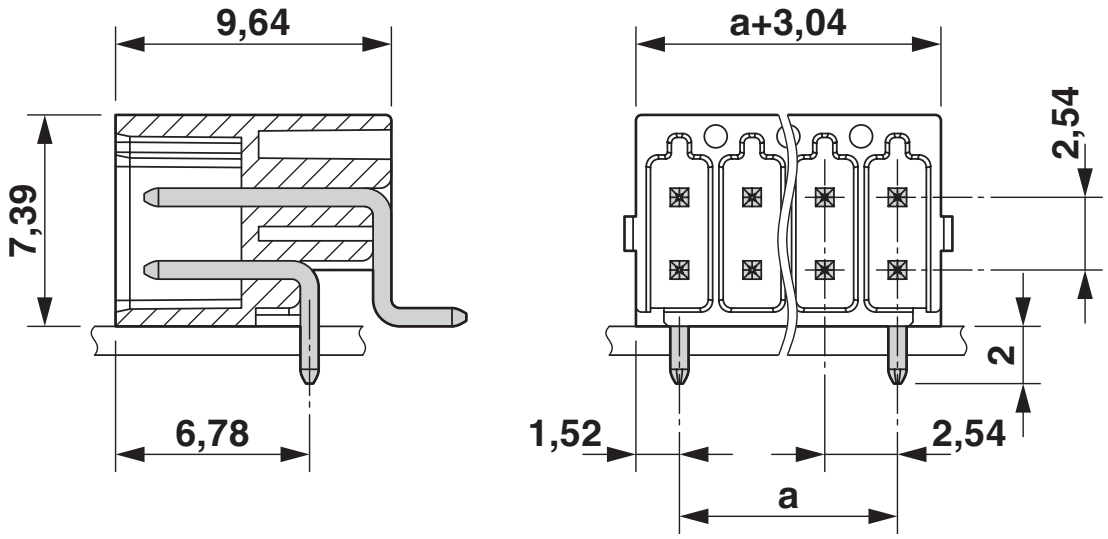
DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Leiterplatten-Grundleiste

1845166

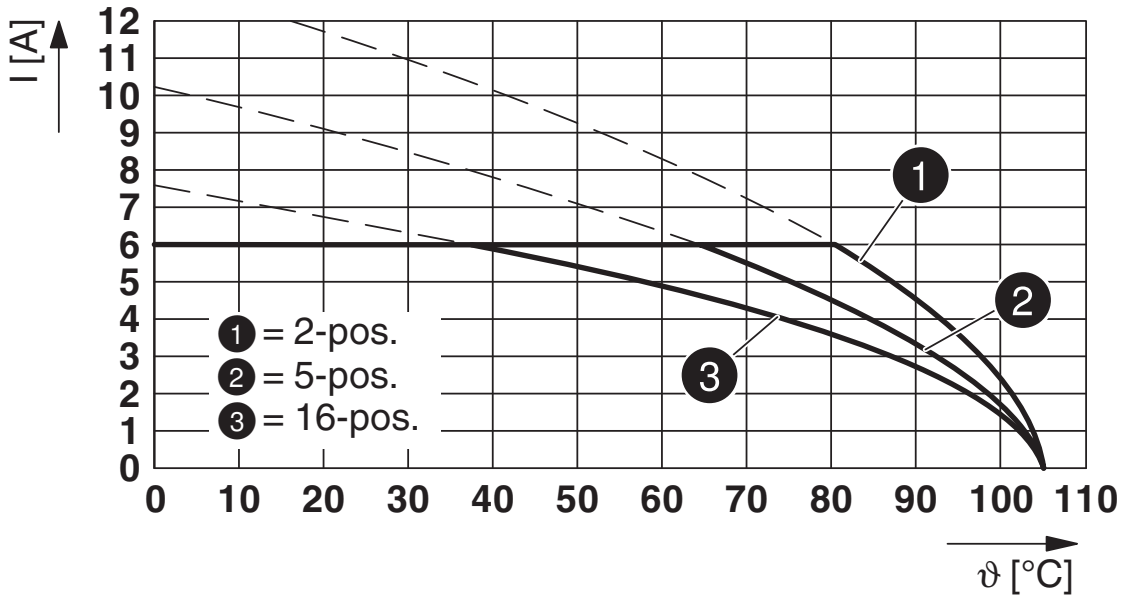
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

Zeichnungen

Maßzeichnung



Diagramm



Typ: DFMC 0,5/...-ST-2,54 mit DMC 0,5/...-G1-2,54 SMD R...

DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Leiterplatten-Grundleiste

1845166

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920306

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	150 V	6 A	-	-
C				
	50 V	6 A	-	-

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40042389

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	160 V	6 A	-	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

DMC 0,5/16-G1-2,54 SMD R72 - Leiterplatten-Grundleiste

1845166

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1845166

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de